

iSpindel hobipivo PCBs

Version 2.0 (Februar 2021) in Vorbereitung

Mit elektronischem Verpolungsschutz

Version 1.0 (Jänner 2021)

Die v1.0 Platine dient nur als Prototyp für v2.0

In Anlehnung ans Jeffrey Board wurde dieses um folgende Punkte geändert/erweitert:

- Erweiterung/Änderung der Platinen-Führungsnasen im PETling

- Aufdruck von gut sichtbaren + - Zeichen für den Akkueinbau

- Änderung der Widerstandspositionen (keine zusätzlichen Durchkontaktierungen)

- Verschiebung des D1 mini Modules näher Richtung Deckel
(Lötstellen von Lademodul beim Wemos nicht mehr im Weg)

- Verschiebung und Änderung des Lademoduls Footprints (Pin-Abstände)

- Änderung des Styles und Position des GY-521 Footprints

- Verwendung von Kupferplanes für VCC und GND



